## 天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 C3 版)

(二)填补被摊薄即期回报的承诺 为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,公司、公司实 际控制人、公司董事及高级管理人员作出承诺如下:

若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本公司将在股东大会及 中国证监会指定银刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本公司作出相关处罚或采取管理措施;对公司其他股东造成损失的,本公司 将依法给予补偿。 2、公司实际控制人的承诺

(1)不会越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益; (2)若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取管理措施;对公司其他股东造成损失的,本人将依法

给予补偿。 3、公司董事、高级管理人员的承诺 (1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他

(2)对职务消费行为进行约束: (3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

(4) 田里華云以新師委贝云·制定的新師制度·司公司填料回报信施的訊目情况相挂钩; (5) 若公司后续推出股权激励计划,承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (6) 若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券会易所对本人。 本人作出相关处罚或采取管理措施;对公司其他股东造成损失的,本人将依法

给予补偿。 七、公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监

事、高级管理人员未履行相关承诺的约束措施 (一)发行人承诺 1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项、公司将在股东大会及 中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。

2.如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失: (1) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,本公司将赔偿投资者损失;

记载、误导性陈述或者重大遗漏后、本公司将赔偿投资者损失; (2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 3、本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施(如该等人员在本公司领薪)。 上述承诺内容系本公司的真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,将依法承担相应责任。 (二)控股股东、实际控制人承诺 1、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,本人将在公司的股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。 2、如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的。

如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,

2、如来因本人不履行相关矛语争项后公司或有其他权负有追放颁失的,本人将依法承担赔偿责任。 3、在本人作为公司的实际控制人期间,如果公司未能履行招股说明书披露的相关承诺事项,给投资者造成损失的,经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的,本人将依法承担赔偿责任。 上述承诺内容系本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,将依法承担相应责任。

(三)持股5%以上企业股东此诺投资、南通华泓、上海金浦、南京金浦承诺1、如果本企业未履行招股说明书披露的承诺事项,本企业将在公司的股 会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的

股东和社会公众投资者道歉。 2、如果因本企业未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。 3.在本企业作为公司持股 5%以上的股东期间,如果公司未能履行招股说

3.在本企业作为公司持股 5%以上的股东规则则,如果公司不能履行组取成明书披露的相关承诺事项,给投资者造成损失的,经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本企业应承担责任的,本企业将依法承担赔偿责任。上述承诺内容系本企业的真实意思表示,本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,将依法承担相应责任。(四)持股 5%以上自然人股东高巧珍,陈佳宇承诺1,如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,本人将在公司的股东大人工。中国记述各类的增估。几五说明书披露的承诺事项,本人将在公司的股东大人工。中国记述各类的增估。几五说明书报路的

会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东 2、如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,

本人将依法承担赔偿责任。 3.在本人作为公司持股5%以上的股东期间,如果公司未能履行招股说明

3、在本人作为公司持股 5%以上的股东期间,如果公司未能履行招股说明书披露的相关承诺事项,给投资者造成损失的,经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的,本人将依法承担赔偿责任。 上述承诺内容系本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,将依法承担相应责任。 (五)全体董事,监事,高级管理人员承诺 1、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,本人将在公司的股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。

2、如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,

本人将依法承担赔偿责任。 3、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,如果公司未履行招股

3、任乎八担正公刊里季、皿季、同双目连八八项间,郑平公司"小原日日间以 说明书披露的相关承诺事项,给投资者造成损失的,经证券监管部门或司法机 关等有权部门认定本人应承担责任的,本人将依法承担赔偿责任。 上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会 公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。上述承诺不因本人

公欢的盈管, 石违风工处事店, 本人将依法承担相应贡任。 工处事店不因本人职务变更、离职等原因而失效。 八、发行前滚存利润分配方案 2021年5月15日, 发行人召开的 2021年第二次临时股东大会会议决议,公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。 九. 发行后公司股利分配政策和未来三年分红规划 2021年5月15日, 发行人召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过的《公司上市后三年股东分红回报规划》,公司发行上市后的利润分配政策和未来三年分红规划如下: 预计上市后, 未来三年内公司嘉将项目将外于建设期, 需要较大的建设资

不来二年分紅规划如下: 预计上市后,未来三年内公司募投项目将处于建设期,需要较大的建设资金投入和流动资金支持,公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此在公司上市后三年内,公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后,以现金方式向股东分配的利润不少于当年实现的可分配利润的

在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监

公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公 司的可持续发展、结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要、建立对投资者持续、稳定的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 (二)利润分配形式 公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现

公司未取现金、反景股利取看一者相结合的方式分配利润,并优先未取现金分配方式。
(三)现金分红的具体条件和比例
如公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润)为正值,且在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一:
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过5,000 万元;
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
董事会制定利润分配方案时,综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段,以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则:
1、在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%;
2、在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的,利润分配方案

下央並可担何口以例如公封 80%; 2.在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的,利润分配方案 中现金分红所占比例应达到 40%; 3.在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的,利润分配方案 中现金分红所占比例应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。公司应当及时行使对全资子公司的股东权利,根据全资子公司公司章程的规定,促成全资子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

(四)股票股利分配的条件 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分

在的条件下,提出股票股利分配预案。 公司采取股票或现金股票相结合的方式分配利润时,应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 (五)利润分配的时间间隔

(五.內個內可尼亞阿可阿阿爾 在满足现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,公司 原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情 况提议公司进行中期现金分约

(六)利润分配应履行的程序 公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出。董事会制定 的利润分配方案需经董事会过半数(其中应包含二分之一以上的独立董事)表 决通过、监事会半数以上监事表决通过。董事会在利润分配方案中应说明留存 的未分配利润的使用计划,独立董事应在董事会申议当年利润分配方案的就 利润分配方案的合理性发表独立意见。公司利润分配方案经董事会、监事会审 议通过后,由董事会提交公司股东大会审议。 涉及利润分配相关议案,公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会 公众股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得 全体独立董事的二分之一以上同意。 公司股东大会在利润分配方案进行审议前,应当通过多种渠道与公众投 资者,特别是中小投资者进行沟通与交流,充分听取公众投资者的意见与诉 求、公司董事会秘书及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上 说明。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确

定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(七)利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境 发生变化,确有必要需调整或变更利润分配政策(包括股东回报规划)的,应经 详细论证,调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证

如需调整利润分配政策,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政 策调整议案,有关调整利润分配政策的过来。需事先征求独立董事及监事会的意见,利润分配政策调整议案需多全体成员过半数(其中包含二分之一以上独立董事)表决通过并经半数以上监事表决通过。经董事会、监事会审议 通过的利润分配政策调整方案,由董事会提交公司股东大会审议。董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因,股东大会审议公司利

润分配政策调整议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议

为充分听取中小股东意见,公司应通过多种渠道与公众投资者,特别是中小投资者进行沟通与交流,并通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股

东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 (九)发行人关于利润分配政策的承诺

发行人就利润分配政策承诺如下:本公司首次公开发行股票并上市局,将严格执行公司为首次公开发行股票并上市局,将严格执行公司为首次公开发行股票并上市制定的《公司章程(草案)》和《公司上市后三年股东分红回报规划》中

票并上市制定的《公司章桯(早案)》和《公司上巾后二平权朱刀红凹IX來以》中规定的利润分配政策。 若本公司未能执行上述承诺内容,将采取下列约束措施: 1.公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。 2.如果因公司未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后,本公司将依法向投资者赔偿损失。 上述承诺内容系本公司的真实意思表示。本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司将依法承担相应责任。 (十)实际控制人关于利润分配政策的承诺 公司实际控制人关于利润分配政策的承诺

(十)实际控制人关于利润分配政策的承诺 公司实际控制人崔学峰、龙波或就利润分配政策承诺如下: 公司首次公开发行股票并上市后,本人将督促公司严格执行公司为首次 公开发行股票并上市制定的《公司章程(草案)》和《公司上市后三年股东分红 回报规划》中规定的利润分配政策。 若本人未能执行上述承诺内容,将采取下列约束措施: 1.本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未 履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 2.如果因本人未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失 的,在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生 效判决后,本人将依法向投资者赔偿损失。 上述承诺内容系本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织 及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。 十、股东信息披露的相关承诺

发行人承诺如下: (一)本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露股东信息; (二)本公司历史沿革中存在的股权代持、委托持股等情形,在提交申请前均已依法解除,不存在股权争议或潜在纠纷等情形;

三)本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股 (四)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直

接或间接持有公司股份情形; (五)本公司不存在以公司股权进行不当利益输送情形;

(六)若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。 十一、特别风险提示 (一)半导体行业波动的风险

公司所处的集成电路专用设备行业不仅受宏观经济周期的影响,而且与消费电子、汽车电子、通信等半导体终端应用领域的发展息息相关。如果全球宏观经济进入下行周期,或半导体产业链下游增长放缓,行业景气度下降,则 半导体厂商可能会减少对于专用设备的投入,进而对公司的经营业绩带来不

)国际贸易摩擦加剧的风险 (二)国际贸易摩擦加剧的风险报告期各期,公司境外销售收入分别为1,107.78万元、3,894.16万元、8,801.84万元和5,741.18万元,占主营业务收入比例分别为15.67%、21.41%、20,98%和27.20%。同时,目前公司部分原材料向境外供应商采购。2022年10月,美国商务部对中国先进计算机和半导体制造项目实施新的出口管制,若未来该等国际贸易摩擦进一步升级或境外客户所在地的贸易政策发生重大变 化、将可能对公司未获销售及进口原材料的采购造成一定的负面影响,进而对公司的生产和经营业绩带来不利影响。

公司的生产和经营业项市来不利家啊。 (三)客户集中度较高的风险 报告期内,公司前五大客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为 63.65%,66.09%、54.80%和 68.83%,客户集中度较高。若公司未来市场拓展情况 不及预期,或公司不能通过技术创新、产品升级等方式及时满足客户的需求, 抑或上述客户因自身经营状况发生变化、导致其对公司产品的采购需求下降, ~\_\_\_\_\_ 可能对公司的经营业绩产生不利影响。 (四)技术研发风险

(四)技术研发风险 公司所处的集成电路专用设备行业属于技术密集型行业,产品研发涉及通信、精密电子测试、微电子、机械设计、软件算法、光电子技术、制冷与低温工程等多种科学技术和学科知识的综合应用,具有较高的技术门槛。 公司主要从事集成电路测试分选设备的研发和制造,需要持续进行技术创新和产品研发,才能保持自身技术优势。如果未来公司不能紧跟集成电路专用设备制造领域的技术发展趋势,对关键前沿技术的研发无法取得预期成果;或无法准确把握市场需求的变化方向、充分满足客户多样化的需求、将可能导致人工程,是有关系是一个大型工程、并不可能导致力。

本次募集资金投资项目均围绕发行人主营业务进行,用于提高研发能力, 广大公司的生产能力,增强公司综合实力,包括"半导体测试设备智能制造及 训新研发中心一期项目"和"年产"1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件 处组件项目",排投人募集资金额为54,681.19万元。如果公司本次募投项目 处据处理证据与数据 的建设进度、项目管理、设备供应等因素不达预期,将影响项目的投资收益,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

、财务报告截止审计截止日后的主要财务信息及经营情况

一、网牙取百飯丘里川飯瓜口/四門工产型型 1日本及工百円20 (一) 财务报告审计截止日后的主要经营状况 发行人财务报告审计基准日是 2022 年 6 月 30 日。截至本招股说明书签署日,发行人经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主要产品的生产模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成等方面均未发生重大变 快工、销售风候及销售价格、主安各厂及陕西商的构成等方面均不发生量入变化、不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。 (二)2022 年度的业绩情况 根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止 日后主要财务信息及经营状况信息披露指引(2020 年修订)》的要求,申报会计

师对发行人 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 2022 年 7-12 月和 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表 1、合并资产负债表主要数据

截至 2022 年 12 月 31 日,发行人资产总额为 81,711.68 万元,较 2021 年末增长 33.34%,主要原因系随着公司生产经营规模扩大,发行人应收账款、存货 固定资产及在建工程金额有所增加所致;负债总额为23,437.81万元,较2021 国上员厂及任金工任金数有所与加州政门股总额公支3,437.617 / 1.17 公公 年末增长 26.08%,主要原因系随着采购结算安排及工程项目施工进度增加,发 行人应付票据余额有所增加所致;归属于母公司所有者权益合计为58,273.87 万元,较2021年末增长36.50%,主要系未分配利润增加所致。

2、合并利润表主要数据

			十四://
报表项目	2022年度	2021年度	变动情况
营业收入	42,601.80	42, 019.39	1.39%
营业利润	18,028.06	17, 985.08	0.24%
利润总额	17,662.72	17, 825.03	-0.91%
净利润	15, 393.15	15, 371.69	0.14%
归属于母公司所有者的净利润	15, 393.15	15, 371.69	0.14%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润	15, 311.73	15, 285.94	0.17%
2022年度,公司实现营业	/收入 42,601.80	万元,归属于母公	司所有者的

利润 15,393.15 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 15,311.73 万元,整体均保持稳定。

表主要财务数据			
			单位:万元
报表项目	2022年7-12月	2021年7-12月	变动情况
营业收入	21, 493.67	22, 085.18	-2.68%
营业利润	8, 796.44	10,013.31	-12.15%
利润总额	8, 803.48	9, 863.09	-10.74%
净利润	7,714.40	8, 527.76	-9.54%
归属于母公司所有者的净利润	7,714.40	8, 527.76	-9.54%
扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润	7, 439.32	8,590.85	-13.40%
67 He of -1 short Abert A North Archer			

2022年7-12月,公司实现营业收入21,493.67万元,归属于母公司所有者的净利润7,714.40万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7.439.32 万元, 经营活动产生的现金流量净额 3,919.71 万元。2022 年 7-12 月 各项财务指标变化主要与当期市场整体行情变动影响相关, 经营活动产生的

虑,2023年1-3月业绩预计情况如下: 2023 年 1-3 月预计实现营业收入 1.06 亿元至 1.11 亿元,比上年同期小幅增长;2023 年 1-3 月预计实现归属于母公司股东的净利润为 0.37 亿元至 0.39 亿元,比上年同期增长 4.90%至 10.14%;2023 年 1-3 月预计实现扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润为 0.37 亿元至 0.38 亿元,比上年同期增长

上述业绩预计为公司初步预计数据,未经会计师审计或审阅,不构成公司

股票种类	境内上市人民币普通股(A股)
每股面值	1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	公司首次公开发行股份数量为1,500万股,公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例为25%
每股发行价格	58.58 元
发行市盈率	22.99 倍 (每股收益按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	11.22元(按截至2022年6月30日经审计归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后预计每股净资产	20.86 元(按截至 2022 年 6 月 30 日经审计归属于母公司所有者的净资产加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	2.81 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式	本次发行采用网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的公众投资者直接定价发行的方式进行,不进行网下询价和配售,网上发行通过上交所交易系统进行
发行对象	在上海证券交易所开设人民币普通股(A股)股东账户的自然人、法人投资者及 其他机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	87,870.00 万元
预计募集资金净额	74,681.19 万元
发行费用概算 (不含税金額)	13,188.81 万元. 主要包括: (1) 年前及保养费用-9,265.00 万元; (2) 审计和股资费用.2,150.00 万元; (3) 律即费用:1,222.17 万元; (4) 用于本次发行的信息按赛费用:498.00 万元; (5) 用于本次发行的货户手续费用:5364 万元

	祝
发行人	天津金海通半导体设备股份有限公司
英文名称	J HT Design Co., Ltd.
注册资本	人民币 4,500.00 万元
法定代表人	崔学峰
成立日期	2012年12月24日
投份公司设立日期	2020年12月18日
<b></b>	天津华苑产业区物华道8号A106
经营范围	自动化控制系统装置制造:电子元器件加工;半导体设备,机电一体化技术开发、 咨询 服务,转让:电子元器件,机械设备,机械配件,通讯设备批发兼零售,货物及 技术进出业务:机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)
邮政编码	300384
电话号码	022-89129719
传真号码	022-89129719
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com
互联网网址	https://www.jht-design.com/

2020年11月30日,金海通有限股东会作出决议,同意将公司类型由有限 责任公司整体变更为股份有限公司,同意以2020年10月31日作为整体变更

的申订和评估基准日。 2020年12月15日,金海通有限召开创立大会暨第一次股东大会,同意金海通有限以公司净资产折股,整体变更为股份有限公司,变更后的公司名称为"天津金海通半导体设备股份有限公司",同意将有限公司截至2020年10月31日经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚审字[2020]361Z0002号《审计报告》审计的净资产246,226,667.80元,按5.4717:1的比例折合为股份公司的股本4,500.00万股,余下的净资产201,226,667.80元作为公司的资本公积。 各发起人以其持有的有限公司权益所对应的净资产出资,变更前后股权比

2020年12月12日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 出具大学评估评报字[2020]840071号《资产评估报告》,确认天津金海通半导体 设备制造有限公司《资产负债表》上列示的净资产的评估值为人民币 28,829.73

2020年12月16日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字

[2020]361Z0114号《赊资报告》,确认截至 2020年 12 月 15 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 4,500.00 万元,出资方式为净资产。
2020年 12 月 18 日,天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》,同意公司名称变更为天津金海通半导体设备股份有限公司。企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司。同日,天津滨海高新技术产业开发互市场比较管理局处司。 业开发区市场监督管理局向公司核发了编号为911201160587336021的

《宫业八元代》。 (二)发起人情况 发行人系金海通有限以截至2020年10月31日经审计的净资产为基础 折股,整体变更设立的股份公司。公司设立时,发起人及持股情况如下: 单位;万股

			平世:月度
序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	崔学峰	851.11	18.91%
2	旭诺投资	536.97	11.93%
3	龙波	534.41	11.88%
4	南通华泓	395.89	8.80%
5	上海金浦	395.85	8.80%
6	南京金浦	296.89	6.60%
7	高巧珍	237.51	5.28%
8	陈佳宇	235.96	5.24%
9	杨永兴	219.69	4.88%
10	聚源聚芯	155.23	3.45%
11	秦维辉	148.36	3.30%
12	杜敏峰	131.25	2.92%
13	余慧莉	114.13	2.54%
14	上海汇付	98.96	2.20%
15	张继跃	91.30	2.03%
16	天津博芯	35.95	0.80%
17	鲍贵军	20.54	0.46%
	人 江	4 500.00	100,000/

、发行人股本情况 一)本次发行前后的股本情况

发行人本次发行前总股本情况 发行人本次发行前总股本为 4,500.00 万股,本次发行 1,500.00 万股新股, 与发行后总股本的比例为 25.00%,发行人股东不公开发售老股。按本次发行 1,500 万股新股测算,本次发行前后公司股本结构如下表:

		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
_	有限售条件股	4,500.00	100.00%	4,500.00	75.00%
1	崔学峰	851.11	18.91%	851.11	14.19%
2	旭诺投资	536.97	11.93%	536.97	8.95%
3	龙波	534.41	11.88%	534.41	8.91%
4	南通华泓	395.89	8.80%	395.89	6.60%
5	上海金浦	395.85	8.80%	395.85	6.60%
6	南京金浦	296.89	6.60%	296.89	4.95%
7	高巧珍	237.51	5.28%	237.51	3.96%
8	陈佳宇	235.96	5.24%	235.96	3.93%
9	杨永兴	219.69	4.88%	219.69	3.66%
10	聚源聚芯	155.23	3.45%	155.23	2.59%
11	秦维辉	148.36	3.30%	148.36	2.47%
12	杜敏峰	131.25	2.92%	131.25	2.19%
13	余慧莉	114.13	2.54%	114.13	1.90%
14	上海汇付	98.96	2.20%	98.96	1.65%
15	张继跃	91.30	2.03%	91.30	1.52%
16	天津博芯	35.95	0.80%	35.95	0.60%
17	鲍贵军	20.54	0.46%	20.54	0.34%
Ξ	无限售条件的流通股	-	-	1,500.00	25.00%
	合计	4,500.00	100.00%	6,000.00	100.00%

截至本招股说明书摘要签署日,发行人前十名股东如下:

			单位:万服
序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	崔学峰	851.11	18.91%
2	旭诺投资	536.97	11.93%
3	龙波	534.41	11.88%
4	南通华泓	395.89	8.80%
5	上海金浦	395.85	8.80%
6	南京金浦	296.89	6.60%
7	高巧珍	237.51	5.28%
8	陈佳宇	235.96	5.24%
9	杨永兴	219.69	4.88%
10	聚源聚芯	155.23	3.45%
	合计	3, 859.51	85.77%

(三)本次发行前的前十名自然人股东 截至本招股说明书摘要签署日,发行人前十名自然人股东具体情况如下:

			单位:万
序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	崔学峰	851.11	18.91%
2	龙波	534.41	11.88%
3	高巧珍	237.51	5.28%
4	陈佳宇	235.96	5.24%
5	杨永兴	219.69	4.88%
6	秦维辉	148.36	3.30%
7	杜敏峰	131.25	2.92%
8	余慧莉	114.13	2.54%
9	张继跃	91.30	2.03%
10	鲍贵军	20.54	0.46%
	VT	2 50420	57.440

(四)发行人国有股份与外资股份的情况 本次发行前,发行人的股本中不存在国有股份或外资股份。 (五)股份流通限制和锁定安排 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 情况详见本摘要"第一节 重大事项提示"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺"。

(六)本次发行前发起人、控股股东和主要股东间的关联关系

崔学峰与龙波为一致行动人。本次发行前,崔学峰直接持有公司18.91%的 股份,龙波直接持有公司 11.88%的股份,同时通过天津博芯间接控制公司 0.80%的股份。

2.龙波与天津博芯 龙波担任天津博芯的执行事务合伙人,并持有天津博芯 1.64%的份额。本 次发行前,龙波直接持有发行人11.88%的股份,天津博芯直接持有发行人

3、崔学峰与天津博芯 崔学峰与天津博芯的有限合伙人崔彦萍系兄妹关系,截至本招股说明书 摘要签署日,崔彦萍持有天津博芯 3.72%的出资额。

4、高巧珍与南通华泓 发行前,南通华泓持有发行人 8.80%的股份

发行前,高巧珍直接持有发行人 5.28%的股份。此外,截至本招股说明书摘要签署日,高巧珍系南通华泓的控股股东华达微电子的股东,持有华达微电子

1.19%股权,从而间接持有发行人 0.11%的股份。5、上海金浦、南京金浦与上海汇付 发行前,上海金浦、南京金浦与上海汇付分别持有发行人 8.80%、6.60%和

此外,上海金浦、南京金浦与上海汇付存在共有的有限合伙人——上海瀚娱动投资有限公司。上海瀚娱动投资有限公司。为别持有上海金浦、南京金浦与上海汇付63.42%、14.75%。9.68%的出资份额。

6、上海金浦与南京金浦 上海全浦和南京全浦公别持有发行人8.80%和6.60%的股份。上海金浦与

上母並用作用兄並用刀別付有又11八 8.80%和 9.80%的权切。上母並用一					
南京金浦存在共有的出资人。具体如下:					
共有出资人	与上海金浦的关系	与南京金浦的关系			
限公司	份额占 0.10%	作为普通合伙人(非执行事务合伙人),出资份额占033%			
上海烁焜企业管理中心 (有限合伙)	作为普通合伙人(非执行事务合伙人),出	作为有限合伙人,出资份额占0.98%			

(三)交引八亚分闸切 (一)主营业务概况 公司是一家从事研发、生产并销售半导体芯片测试设备的高新技术企业, 属于集成电路和高端装备制造产业,公司深耕集成电路测试分选机(Test handler)领域,主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等

属土集成电路和高端装备制造产业、公司涂耕集成电路测试分选机(Test handler)领域,主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。自公司成立以来,一直专注于全球半导体芯片测试设备领域、同时致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展,以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。 在集成电路测试分选机领域、公司经过多年的研发和创新,产品的主要技术指标及功能达到国际先进水平。公司的测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成,可以精准模拟芯片真实使用环境,并实现多工位并行测试,其UPH(单位小时产出)最大可达到13,500颗,Jam rate 故障停机率)低于1/10,000、可测试芯片尺寸范围可涵盖 2\*2mm-100\*100mm,可模拟 -55℃~155℃等各种极端温度环境。发行人的核心技术集中于"高速运动姿态自适应控制技术"、"二维精度位置补偿技术"、"压力精度控制及自平衡技术"、"运动轨迹优化技术"、"高速高精度多工位同测技术"、"高兼容性上下科技术"等高精度温控技术"、"芯片全周期流程监控技术"、"高精度视觉定位识别技术"等,科技创新能力突出,具备较强的核心竞争力。公司是 2021 年度天津市"专精特新"中小企业,目前已通过国家级"专特特新小巨人"公示期,独立承担了国家科技重大专项之"极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项"(02 专项)中的"SIP 吸放式全自动测试分选机"的课题研发工作,并获得了"国家重大科技专项课题验证合同书"。通过承担"02 专项",公司产品得到了长电科技及通富微电等大型集成电路封测企业的认可。自成立以来,公司主营业务及主要产品未发生重大变化(二)主要产品概况发行人主要为知名半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业(半导体对达数法)

(二)王安广品版优 发行人主要为知名半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业(半导体 设计制造一体化厂商)、芯片设计公司等提供自动化测试设备中的测试分选机 及相关定制化设备。公司主要深耕平移式测试分选机领域,产品根据可测试工 位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED6000 系列、EXCEED8000 系列、 SUMMIT系列、PUPPY&COLLIE系列、NEOCEED系列等。具体如下表所示:

产品整号	产品图录	技术特点	产品应用
EXCEED6000 亳列平移式 到成分选机	Posterio -	1. 可支持最多 8 工信并 行列域; 2. 可提供常益、制造(最 高可达 155°C) 列域环境; 3. UPH 最大 8,000颗。	構配标注测试 机或例式板,对 心.元进行多工 位并行对记。
EXCEPTIBODO 星列平砂式 排成分选机		1. 可支持景於 16工位 并行測式。 2. 可移业低名(最低产 达5570)、實益、高温 (最高可以 1570)测 试环境以及 ATC至均位 显功能。 3. UPE最大可达 13,500 類。	構配标注测试 机或例试标: 对 芯片进行多工 位并行列试。
SUMMIT 卓 列系統線則 減火遊机		1、可數學學多 16 T位 独立別狀,每不例以二 位与例式系統建立定 達。 2、可受共儒區、常温、 度温测铼等類以及 AID 主动起程功能。 3、例表示的总片可分 洗成套份 17 种类别。	搭部以下C主接 为证认系统的 测试机时系统 级老片如 CPU、GPU关 产品进行独立 测试。
PUPPY. COLLEE 系列 工程则设分 运机		1. 为甲工位汇法。 2、可提供收益、定温。 在温测记环境。 3、负留多关道还探口。 更换负着油具及修力快 排。	搭配标准例试 机或测点板 通 常对用于实验 宣、研究所进行 工程词读或小 批巴生产。
NBOCEED 杂 列平移式河 试外选机		1、可支柱最多 16 五位 并行测域。 2、可提供给基(最新可 以4.55°C)、常温、高温 (最高可达 155°C)例	搭配标准测试 机或测试板,可 对芯片进行多 工位主待测试。

公司是一家为客户提供高效、定制化、全自动集成电路封装测试专用设备的高新技术企业。报告期内,公司主营业务收入主要来源于 EXCEED6000 系 列、EXCEED8000系列、其他系列等各类测试分选机产品的销售。

3、支持日助\_\_下科管。

公未购模式 公司采购采取询价方式,综合考虑供应商产品品质、价格、交付能力等多 方面因素选择供应商,报告期内主要供应商保持相对稳定。 公司产品的结构复杂且具备定制化属性,每台设备需配备上千个零部件, 产品生产需采购的原材料种类较多,报告期内有多种不同种类、不同规格的原 材料,具体可以分为电器类、机械类、钣金类、传动类、控制类及其他类等。

其中,采购的步进电机、伺服电机、光纤传感器、电磁阀、真空发生器等 般为市场上的通用型号的标准件;对部分部件有特殊设计需求,采取"自主设 计,外部采购"的方式完成,如加热棒、热电阻等电器加工件和基板、钣金等机 械加工件,由公司进行自主设计,供应商根据公司设计图纸对原材料进行生产 加工,公司最终采购成品。

公司的采购工作主要涉及公司的制造部、质量部和采购部。公司制造部综 合客户订单情况、行业趋势等因素,按照"以销定产"和"安全库存"的形式确定生产计划以及物料需求计划;质量部根据每年的供应商交货良率进行评估;采购部根据采购需求、结合供应商的产品质量和交货能力、与供应商协商询价比 选,确定各供应商的采购数量和采购价格等,最终确定采购订单并执行采购。

公司产品具有较强的定制化属性,公司主要实行"以销定产"和"安全库 存"的生产模式,结合库存和市场情况确定产量。公司自身涉及生产环节主要 体现在整机设备定制方案设计、部分零部件的生产加工、软件的安装、整机装 配和调试等步骤;部分零部件通过直接采购或者"自主设计,外部采购"的方式

完成,对机械手臂、测试手臂、浮动机构等部分零部件会自行生产加 公司的生产模式具体为:公司将物料送至制造部,进行进出盘模块、上下 料模块、测试区模块、抓盘模块等组件的生产加工和装配,各模块组装完毕后 进行整机的装配工作,再将发行人自主研发的软件程序安装到设备中;最后依 次进行运行控制精度、速度、温控、视觉识别的调试和整机测试,检验合格后包

4、销售及定价模式

(1)销售模式 公司主要的销售模式有直销模式和代理模式,客户群体主要分布在中国 大陆、中国台湾、东南亚、欧美等半导体研发、加工产业发达的国家和地区,其 中,境内销售以直销模式为主,境外销售主要有直销和代理模式。针对直销模 式与代理模式、公司主要与终端客户直接签署销售合同。代理模式下、债客户验收设备并支付货款后,公司根据代理协议支付代理商相应佣金,一般为成交

为及时掌握客户需求及市场动态,公司先后在香港、新加坡、马来西亚成 立境外公司,负责业务的开拓及客户维护,以提升品牌知名度。同时,公司银 完善的售后服务体系。公司销售部下属的产品支持部直接负责产品售后服务 工作,有完整的售后服务流程。公司专业、快捷的售后服务能力在业内树立了

(2)定价模式
公司产品结构复杂且定制化属性较强,需采购的原材料种类较多,报告期
内有多种不同种类、不同规格的原材料,上游采购价格与下游产品价格之间传
导具有一定的滞后性,公司根据产品设计方案及产品生产所需的原材料成本
为基础,并综合考虑产品的技术要求,设计开发难度、创新程度、产品需求量、
生产周期、下游应用行业及竞争情况等因素,确定产品的价格。同时,公司持续
跟踪产品的市场情况,在出现设计优化、原材料价格波动,汇率波动及出口退
税政策变化等必要情形时,及时对产品价格进行相应的调整。
主要定价方式;在成本核算的基础上,结合市场及竞争对手情况,对具体
产品设定指导价,并根据客户对配置和服务的要求,调整报价,协商确定最终
销售价格。

(下转 C5 版)